



Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Especificaciones

- Puntos fundamentales
 - Desempeño
 - Especificaciones de memoria
 - Especificaciones de gráficos
- Opciones de expansión
- Especificaciones de paquete
- Tecnologías avanzadas
 - Tecnología de protección de datos Intel®
 - Tecnología de protección de plataforma Intel®

Especificaciones

Puntos fundamentales	
Estado	Launched
Fecha de lanzamiento	Q3'15
Número de procesador	G4400
Caché inteligente Intel®	3 MB
DMI3	8 GT/s
Conjunto de instrucciones	64-bit
Extensiones de conjunto de instrucciones	SSE4.1/4.2
Opciones integradas disponibles	Yes
Litografía	14 nm
Escalabilidad	1S Only
Especificación de solución térmica	PCG 2015C (65W)
Desempeño	
Cantidad de núcleos	2
Cantidad de subprocesos	2
Frecuencia básica del procesador	3.3 GHz
TDP	54 W
Especificaciones de memoria	
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria)	64 GB
Tipos de memoria	DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
Cantidad máxima de canales de memoria	2
Máximo de ancho de banda de memoria	34,1 GB/s
Compatible con memoria ECC †	Yes
Especificaciones de gráficos	
Gráficos del procesador †	Intel® HD Graphics 510
Frecuencia de base de gráficos	350 MHz
Frecuencia dinámica máxima de gráficos	1 GHz
Memoria máxima de video de gráficos	1.7 GB
Salida de gráficos	eDP/DP/HDMI/DVI
Compatibilidad con 4K	Yes, at 60Hz
Resolución máxima (Intel® WiDi)‡	1080p
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡	4096x2304@24Hz
Resolución máxima (DP)‡	4096x2304@60Hz
Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡	4096x2304@60Hz
Resolución máxima (VGA)‡	N/A
Compatibilidad con DirectX*	12
Compatibilidad con OpenGL*	4.4
Intel® Quick Sync Video	Yes
Tecnología Intel® InTru™ 3D	Yes
Intel® Insider™	Yes
Intel® Wireless Display	Yes
Tecnología Intel® HD de video nítido	Yes
Tecnología Intel® de video nítido	Yes
Nº de pantallas admitidas †	3
ID de dispositivo	0x1902
Opciones de expansión	
Revisión de PCI Express	3.0
Configuraciones de PCI Express †	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Cantidad máxima de líneas PCI Express	16
Especificaciones de paquete	
Máxima configuración de CPU	1
Tamaño de paquete	37.5mm x 37.5mm
Litografía de IMC y gráficos	14 nm
Zócalos compatibles	FCLGA1151
Baja concentración de opciones de halógenos disponibles	Ver MDDS
Tecnologías avanzadas	
Versión de la tecnología Intel® Turbo Boost †	No
Tecnología Intel® vPro †	No
Tecnología Hyper-Threading Intel® †	No
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) †	Yes
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) †	Yes
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) †	Yes
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions	No
Intel® 64 †	Yes
Estados de inactividad	Yes
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada	Yes
Tecnologías de monitoreo térmico	Yes
Tecnología Intel® Identity Protection †	Yes
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP)	No
Ventaja Intel® para pequeñas empresas	No
Tecnología de protección de datos Intel®	
Nuevas instrucciones de AES Intel®	Yes
Secure Key	Yes
Extensiones de guarda de software Intel®	Yes
Extensiones de protección de la memoria Intel®	No
Tecnología de protección de plataforma Intel®	
OS Guard	No
Tecnología Trusted Execution †	No
Bit de desactivación de ejecución †	Yes

Toda la información suministrada está sujeta a cambio en cualquier momento, sin aviso. Es posible que Intel modifique el ciclo de vida de fabricación, las especificaciones y las descripciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso. La información aquí incluida se suministra "como está" e Intel no hace ninguna manifestación ni emite ninguna garantía en relación con la exactitud de la información, ni sobre las características, disponibilidad, funcionalidad o compatibilidad de los productos mencionados. Comuníquese con el proveedor del sistema para ver más información sobre productos o sistemas específicos.

Las "clasificaciones de Intel" consisten en números de clasificación de control de exportaciones (ECCN) y números del Sistema arancelario armonizado (HTS). Cualquier uso de las clasificaciones de Intel se realiza sin recurrir a Intel y no se considera como una representación o garantía respecto al ECCN o HTS adecuado. Su empresa puede ser la exportadora registrada y, como tal, es responsable de determinar la clasificación correcta de cualquier artículo al momento de exportarlo.

Consulte la hoja de datos para las ver definiciones formales de las propiedades y funciones del producto.

Las SKU "anunciadas" no están aún disponibles. Consulte la fecha de lanzamiento para saber cuándo estará disponible en el mercado.

Algunos productos pueden admitir instrucciones nuevas de AES con una actualización de la configuración del procesador, en particular, I7-2630QM/I7-2688QM, I7-2670QM/I7-2678QM, I8-2430M/I8-2435M, I8-2410M/I8-2415M. Póngase en contacto con el fabricante del BIOS que incluye la actualización del procesador más reciente de configuración.

† Puede que esta función no esté disponible en todos los sistemas informáticos. Póngase en contacto con su proveedor de sistemas para saber si su sistema ofrece esta función o consulte las especificaciones del sistema (placa base, procesador, chipset, fuente de alimentación, disco duro, controladora de gráficos, memoria, BIOS, controladores, monitor de máquina virtual (VMH), software de plataforma y/o sistema operativo) para comprobar la compatibilidad con la función. La funcionalidad, el rendimiento y otras ventajas de esta función pueden variar según la configuración del sistema.

"Libre de conflictos" significa "libre de conflictos de RDC", definición utilizada por la normativa de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. para referirse a los productos que no contienen minerales conflictivos (estaño, tántalo, tungsteno y/u oro) que directa o indirectamente financian a grupos armados en la República Democrática del Congo (RDC) o países vecinos. Intel utiliza también el término "libre de conflictos" en un sentido más amplio para hacer referencia a proveedores, cadenas de suministro, fundiciones y refinadoras cuyas fuentes de minerales conflictivos no financian conflictos en la RDC o en países limítrofes fabricados antes del 1 de enero de 2013 no tienen la designación de producto libre de conflictos. La designación "libre de conflictos" únicamente se refiere a los productos fabricados a partir de esa fecha. Para los procesadores Intel en caja, la designación "libre de conflictos" se refiere solo al procesador, no a los accesorios adicionales incluidos, como disipadores de calor o refrigeradores.

Consulte <http://www.intel.com/content/www/es/es/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading> para obtener más información incluyendo detalles sobre los procesadores compatibles con la tecnología Intel® HT.

La frecuencia máxima de turbo hace referencia a la frecuencia máxima de un procesador de un solo núcleo que se puede conseguir con la tecnología Intel® Turbo Boost. Consulte www.intel.com/content/www/es/es/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html para obtener más información.

Para los productos Intel, se recomienda consultar la guía sobre precios de venta al público recomendados. Los precios son para clientes directos de Intel, normalmente representan cantidades de compra de 1.000 unidades y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los impuestos, gastos de envío, etc. no están incluidos. Los precios pueden variar para otros tipos de embalaje y cantidades de envío y pueden aplicarse promociones especiales. Si se vende en lotes, el precio representa una unidad individual. Este material es meramente orientativo y no constituye ningún tipo de oferta formal por parte de Intel. Póngase en contacto con el representante de Intel concreto para obtener toda la información precisa sobre presupuestos y precios.

TDP máximo y de sistema se basa en el peor de los escenarios. El TDP real puede ser menor si no se utilizan todas las E/S para los chipsets.

Baja concentración de halógenos: sólo se aplica a los retardantes de llama bromados y clorados (BFR/CFR) y PVC en el producto final. Los componentes de Intel así como los que se puedan adquirir para el ensamblaje final cumplen con la normativa RoHS y la placa de circuito impreso/substrato, con la IEC 61249-2-21. El uso de retardantes de llama halógenos o de PVC no es beneficioso para el medio ambiente.

Para ver los datos del análisis de rendimiento, consulte <http://www.intel.com/content/www/es/es/benchmarks/intel-product-performance.html>.

Los números de procesador Intel no son una medida del rendimiento. Los números de procesador diferencian características dentro de cada familia de procesadores, pero no a través de las diferentes familias de procesadores. Consulte www.intel.com/content/www/es/es/processors/processor-numbers.html para obtener más detalles.